

1-146460-4 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU Headers

TE 内部编号 1-146460-4

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 14 Position, 2.54 mm

[.1 in] Centerline, Breakaway, Tin-Lead, Through Hole - Solder,

AMPMODU Headers

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 14

行数: 1

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 垂直

## 产品特性

### 产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| 连接器系统       | 板对板      |
| 接头类型        | 分离       |
| 可密封         | 否        |
| 连接器和端子端接到   | 印刷电路板    |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |

### 结构特性

|          |    |
|----------|----|
| 板对板配置    | 平行 |
| 可堆叠      | 是  |
| 位数       | 14 |
| 行数       | 1  |
| PCB 安装方向 | 垂直 |

### 电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 绝缘电阻 | 5000 MΩ |
|------|---------|

### 主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

### 接触件特性

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 端子接触部长度 | 2.79 mm [.109 in] |
| 接合方柱尺寸  | .64 mm [.025 in]  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度   | 2.54 – 5.08 $\mu\text{m}$ [100 – 200 $\mu\text{in}$ ] |
| 端子布局               | 直插式   |
| 端子底板材料厚度           | 1.27 $\mu\text{m}$ [50 $\mu\text{in}$ ]               |
| 端子接合区域电镀材料厚度       | 2.54 – 5.08 $\mu\text{m}$ [100 – 200 $\mu\text{in}$ ] |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光  |
| 端子形状和构造            | 正方形   |
| 端子底板材料             | 镍   |
| PCB 端子端接区域电镀材料     | 锡铅  |
| 端子基材               | 铜合金   |
| 端子接触部电镀材料          | 锡铅  |
| 端子类型               | 插针  |
| 端子额定电流 (最大值)       | 3 A   |

#### 端接特性

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 方形端接柱体和尾部尺寸 | .64 mm[.025 in]  |
| 端接柱体和尾部长度   | 1.45 mm[.057 in] |
| PCB 端接方法    | 通孔 - 焊接          |

#### 机械附件

|          |     |
|----------|-----|
| 连接器安装类型  | 板安装 |
| 接合对准     | 不带  |
| PCB 安装对准 | 不带  |
| PCB 安装固定 | 不带  |

#### 壳体特性

|          |                |
|----------|----------------|
| 外壳材料     | 热塑性            |
| 中心线 (间距) | 2.54 mm[.1 in] |

#### 尺寸

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 堆叠高度        | 11.43 mm[.45 in] |
| PCB 厚度 (建议) | 1.57 mm[.062 in] |

#### 使用环境

|        |  |
|--------|--|
| 工作温度范围 | -65 – 125 $^{\circ}\text{C}$ [-85 – 257 $^{\circ}\text{F}$ ] |
|--------|--|

#### 操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

#### 行业标准



|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 与机构/标准产品兼容  | CSA, UL               |
| 与已批准的标准产品兼容 | CSA LR7189, UL E28476 |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0              |

### 包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装数量 | 140    |
| 封装方法 | Carton |

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|   |   |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合   |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值  |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (13% in Component Part)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量  | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。  |
| 焊接工艺能力  | 波峰焊接可达到 240°C   |

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



## 该系列中的其他产品 | AMPMODU Headers



## 客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[14 MODII HDR SRST UNSHRD STKG](#)

英文版本

---

### 数据表/目录页

[AMPMODU Interconnection System](#)

[AMPMODU Interconnection System](#)

英文版本